

微电子芯片自吸附盒硅凝胶材料 全透明高粘性硅凝胶

产品名称	微电子芯片自吸附盒硅凝胶材料 全透明高粘性硅凝胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	68.00/件
规格参数	品牌:硅诚硅胶 用途:自吸附盒硅凝胶 类型:高粘型
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

微电子芯片自吸附盒硅凝胶材料 全透明高粘性硅凝胶

简介：

自吸附盒硅凝胶应用于运输、加工，检验和装配过程中保护和储存敏感装置和样品。其核心的硅凝胶是一种非常耐用和多用途的材料，在-40 °C至220 °C之间都能保持自身的特性不受影响，可在常温环境下自然硫化，且粘附强度高，可确保产品在盒内倾斜、晃动不受影响；食品级硅凝胶材料对产品无污染无腐蚀性，可长期重复使用。应用于半导体器件，传感器，微机械器件，光学材料，硬盘驱动器头，生物医学设备，标本存储等。

产品特点：

1、有防水、防潮、耐老化、耐紫外线照射、耐机械冲击和减震的优良性

能；

- 2、硫化时无低分子放出，收缩率小于0.1%、无腐蚀性；
- 3、粘度很低，基本和水无差异，流动性很好，方便灌封操作；
- 4、硅凝胶和铝材，镀锌板，不锈钢等有良好的粘接性；
- 5、硫化后的硅凝胶具有自粘性、可自愈合性，可修复性，能够节省成本；
- 6、耐高低温性能突出，可在-50—200 长期使用；
- 7、高透明材料，可免开盖检查元器件产品。
- 7、具有良好的阻燃性能，可达UL94V0阻燃级。

吸附盒硅凝胶材料性能参数：

外观：透明、淡蓝色透明液体

粘度：1000-1500

密度（g/cm³）：1.08

混合比例：1:1

操作时间：1-2小时（可调节）

硫化时间：4-6小时（可调节）

锥入度（25℃）1/100mm：50-150

击穿电阻率MV/m：20

体积电阻率 .cm: 1×10^{14} (14次方)

介电常数 (1MHz) : 3.2

介质损耗 (1MHz) : 1×10^{-3} (-3次方)

运用方法 :

- 1、胶料AB混合后尽量真空脱泡处理，以免导致气孔影响吸附盒平整度。
- 2、如高温加速硫化时，需注意吸附盒基材的耐温上限，硅凝胶材料耐温可达220 。
- 3、应避免与含N、P、S的化合物以及重金属As、Pb、Sn、Bi等物质接触，以免影响硅凝胶固化。
- 4、混合好的胶料应在操作时间内使用完，以免材料交联，失去流动性，

无法操作。

注意事项:

- 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼。
- 3、存放一段时间后，胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 4、胶液接触以下化学物质会使产品不固化：
 - 1) 有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。
 - 2) liuhuang、硫化物以及含硫的橡胶等材料。
 - 3) 胺类化合物以及含胺的材料。

在使用过程中，请注意避免与上述物质接触。

微电子芯片自吸附盒硅凝胶材料 全透明高粘性硅凝胶

芯片定位封装有机硅凝胶材料 粘性好的高透明硅凝胶

